

意法半導體將於義大利興建整合式碳化矽基板製造廠

- 將成歐洲首座碳化矽磊晶基板製造廠
- 完全垂直整合，為碳化矽元件及解決方案強化基板供應，以協助汽車及工業客戶邁向電氣化並提升效率

【台北訊，2022 年 10 月 6 日】— 服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱 ST；紐約證券交易所代碼：STM）將於義大利興建一座整合式碳化矽（Silicon Carbide；SiC）基板製造廠，以支援意法半導體客戶對汽車及工業用碳化矽元件與日俱增的需求，協助其邁向電氣化並追求更高效率。新廠預計 2023 年開始投產，讓碳化矽基板的供應能在對內採購及業者供貨間達到平衡。

這座碳化矽基板廠將設立在意大利半島位於義大利卡塔尼亞（Catania）的一處廠址，鄰近該公司既有的碳化矽元件製造廠，未來將成為歐洲首座 6 吋碳化矽磊晶基板的量產基地，整合生產流程中所有程序。意法半導體已誓言未來下一步將開發 8 吋晶圓。

本計畫對意法半導體推動碳化矽業務垂直整合的策略來說，是極為關鍵的一步。這項在五年內投資 7.3 億歐元的計畫，將由義大利政府透過國家復甦暨韌性計畫（National Recovery and Resilience Plan）提供金援，全面完工後可新增約 700 個直接工作機會。

意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，「意法半導體正在全球推動旗下製造業務的轉型，藉由提升 8 吋晶圓製造產能並強化專注於寬能隙半導體業務，以支援我們突破 200 億美元營收的遠大目標。我們將在卡塔尼亞擴大營運，這裡不但是我們功率半導體專業技術的中心，也透過與義大利研究機構、大學和供應商緊密的協力合作，整合碳化矽的研究、開發與製造。這座新廠將成為我們碳化矽垂直整合的關鍵，強化我們的碳化矽基板供應，協助我們提升產能，以支援車用及工業客戶邁向電氣化並追求更高效率。」

意法半導體之所以在碳化矽領域享有領導地位，乃因為 25 年來專注於投入研發工作，已擁有大量關鍵專利組合。多年來卡塔尼亞一直是意法半導體重要的創新據點，亦是碳化矽研發及製造業務的最大基地，成功開發出許多新的解決方案，協助製造出更多、更好的碳化矽元件。透過既有的功率電子生態系統，包含意法半導體與不同利益關係人（大學、與義大利國家研究委員會相關的設備及產品製造商）之間長期且成功的合作關係，以及龐大的供應商網絡，這項投資案將強化卡塔尼亞做為碳化矽技術及未來成長契機之全球競爭力中心的地位。

意法半導體先進的量產碳化矽產品 STPOWER SiC，目前由位於卡塔尼亞及新加坡宏茂橋的晶圓廠進行生產。封裝測試等後端製程則在中國大陸深圳及摩洛哥的布斯庫拉 (Bouskoura) 完成。這次的碳化矽基板廠投資案，就是以上述專業技術為基礎，對意法半導體於 2024 年之前達到 40%基板來自內部採購的目標來說，無疑是一重大里程碑。

關於意法半導體

意法半導體擁有48,000名半導體技術的創造者和創新者，掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。身為一家半導體垂直整合製造商 (IDM)，意法半導體與逾二十萬家客戶、數千名合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同建立生態系統，協助利益關係人因應各種挑戰和新機會，滿足世界對永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，電力和能源管理更高效，物聯網和互聯技術應用更廣泛。意法半導體承諾將於2027年實現碳中和。詳情請瀏覽意法半導體公司網站：www.st.com。